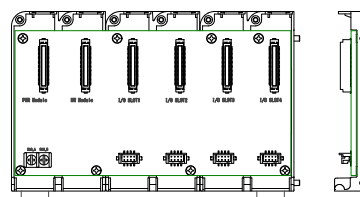


概要

本製品は、MRH-T シリーズの電源、通信、IO モジュールを実装するための専用ベースユニットです。

電源モジュールからの DC24V を一括で各モジュールに供給し、通信モジュールと IO モジュール間を内部通信バスで接続しています。



型式コード

MRH-T-BP06S1

型式

仕様

●基準性能

スロット数 6スロット

電源モジュール×1スロット

通信モジュール×1スロット

IO モジュール×4スロット

RAS 出力 Photo MOS リレー: a 接点
出力定格: 100V/350mA (ピーク AC、DC)
通信モジュール異常時: OPEN

絶縁抵抗 100M Ω 以上 (DC500V): 内部回路—
RAS 出力—外部電源(※) 各間
※外部電源 各間: 100M Ω 以上 (DC500V)

耐電圧 AC1500V/1分間: 内部回路—
RAS 出力—外部電源(※) 各間
※外部電源 各間: AC1500V/1分間

動作環境 温度: -5 $^{\circ}$ C~55 $^{\circ}$ C
湿度: 5~90%RH (結露なきこと)

保存温度 -10~60 $^{\circ}$ C

●取付・形状

取付方法 DINレール取付

取付姿勢 垂直

配線方法 RAS 出力端子台: M3 ネジ端子接続
外部電源入力用コネクタ:
DF11CZ-8DP-2V (27) (HRS 社製)

ネジ締付トルク 0.65N \cdot m \pm 15%

適合圧着端子 R1.25-3 (JST、ニチブ社製) or 相当品

適合電線 0.3~0.75mm²

外形寸法 W176 \times H115 \times D21mm (突起部含まず)

質量 195g typ.

●材質

本体ケース ABS樹脂 (UL-94V-0)

端子台ネジ 鉄/ニッケルメッキ

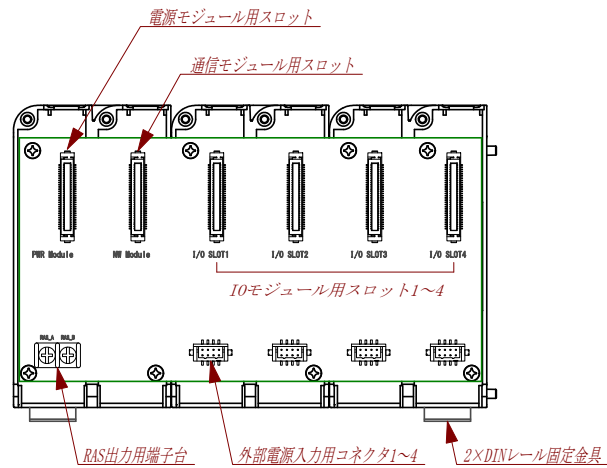
基板 ガラスエポキシ (FR-4、UL94V-0)

防湿処理 HumiSeal[®] 1A27NSLU (ポリウレタン樹脂)

※HumiSeal[®]は Chase Corporation の登録商標です。

実装位置図

電源モジュールは、左端のスロット（シルク印字：PWR Module）に実装してください。
 通信モジュールは、左から 2 番目のスロット（シルク印字：NW Module）に実装してください。
 IO モジュールは、左から 3 番目のスロット～右端のスロット（シルク印字：I/O SLOT1～I/O SLOT4）に実装して下さい。
 電源モジュール用スロットの下側に RAS 出力用端子台、IO モジュール用スロットの下側に各 IO モジュールの外部電源入力用コネクタを実装しています。



外形寸法

